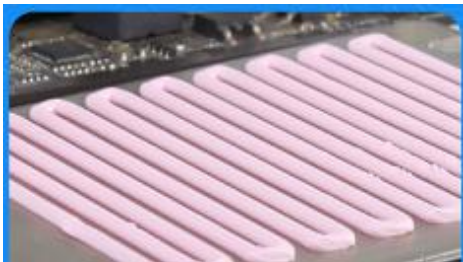


# 导热凝胶

## 【产品概述】

SE60 是一种柔软的单组份硅树脂基导热缝隙填充材料，具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性，是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE60 可通过手工方式或点胶设备来进行涂装。

## 【产品图示】



## 【产品应用】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

**【储存&运输】** 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输。

**【包装】** ● 30cc ; ● 300cc 。

**【有效期】** 本产品有效期为 12 个月

**【安全】** 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

特性参数 SE60		
产品性能	测试结果	测试方法
颜色	粉红色	目测
挤出速度 (30ccEFDcartridges1” orifice 90psi)	10g/min	***
密度/Density	3.38g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
体积电阻	>10 <sup>13</sup> Ω cm	ASTM D257
导热系数	6.0W/m.K	ASTM D5470
介电击穿强度	>200 VAC/mil	ASTM D149
介电常数	5.0	ASTM D150
热阻/Thermal Resistance@40min, 20psi	2.7×10 <sup>-5</sup>	ASTM D5470
锥入度/Cone penetration	178	GB/T269—91
出油率/%	1.25%	140°C 100H 出油
最小介面厚度	0.09mm	--
使用温度	-50~200°C	--
存放时间	12month	--
硅烷小分子析出 D3~D12 含量	<300PPM	GB/T 27843-2011
阻燃性	V-0	UL 94
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5%，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。